第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅年度报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交2026年年度股东大会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用□不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	中芯国际	688981	不适用
港股	香港联交所主板	中芯国际	00981	不适用

(二)公司存托凭证简况

□适用√不适用

(三)联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郭光莉	温捷涵
联系地址	中国上海市浦东新区张江路18号	中国上海市浦东新区张江路18号
电话	021-20812800	021-20812800
电子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

除集成电路晶圆代工外，集团亦致力于打造平台式的生态服务模式，为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造等一站式配套服务，并促进集成电路产业链的上下游协同，与产业链中各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司主要从事基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务，并提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。

2.研发模式

公司具备完整、高效的创新机制，完善的研发流程管理制度和专业的研发团队，推进应用平台的研发，进一步夯实技术基础，构建技术壁垒。公司的研发流程主要包括七个阶段，即项目选择、可行性评估、项目立项、技术开发、技术验证、产品验证和产品投产，每个阶段均有严格的审批流程，从而确保研发项目的成功转化。

3.采购模式

公司主要向供应商采购集成电路晶圆代工及配套服务所需的物料、零备件、设备、软件及技术服务等。为提高生产效率，加强成本控制，公司建立了采购管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体系与较为完善的供应链安全体系，建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制，在与主要供应商保持长期合作关系的同时，兼顾新供应商的导入与培养，加强供应链的稳定与安全。

4.生产模式

公司按市场需求规划产能，并按计划进行投产，具体如下：

(1)小批量试产：客户按照公司提供的设计规则进行产品设计。设计完成后，公司根据客户的产品要求进行小批量试产。

(2)风险量产：小批量试产后的样品经封装测试、功能验证等环节，如符合市场要求，则进入风险量产阶段。风险量产阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等。

(3)批量生产：风险量产阶段完成且上述各项交付指标达标后，进入批量生产阶段。在批量生产阶段，销售部门与客户确认采购订单量，生产计划部门根据客户订单需求安排生产，跟踪生产进度并向客户提供生产进度报告。

5.营销及销售模式

公司采用多种营销方式，积极通过各种渠道拓展客户。在与客户建立合作关系后，公司与客户直接沟通并制定符合其需求的解决方案。

公司通过市场研究，主动联系并拜访目标客户，推介与客户匹配的工艺和服务，进而展开一系列的客户拓展活动。公司通过与设计服务公司、IP供应商、EDA厂商、封装测试厂商、行业协会及各集成电路产业促进中心合作，与客户建立合作关系。公司通过主办技术研讨会等活动或参与半导体行业各种专业会展、峰会、论坛进行推广活动并获取客户。部分客户通过公司网站、口碑传播等公开渠道联系公司寻求直接合作。公司销售团队与客户签订订单，并根据订单要求提供集成电路晶圆代工以及相关配套服务，制造完成的产品最终将被发货至客户或其指定的下游封装、测试厂商。

公司结合市场供需情况、上下游发展状况、公司主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段等因素，形成了目前的晶圆代工模式。报告期内，上述经营模式的关键因素未发生重大变化。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2025年，全球半导体产业产值持续攀升，供应链协同效应显现。受下游应用场景多元化影响，各细分领域呈现出差异化的演进格局：受生成式AI、数据中心及自动驾驶等领域的需求推动，算力芯片及存储芯片贡献了整体市场规模增量的核心动能。在智能终端迭代升级的温和刺激下，消费电子、智能手机、电脑、可穿戴设备等产品的换机需求呈现渐进式释放。汽车电子领域实现触底反弹，叠加产业链在地化生产需求大幅提升，本土晶圆厂通过车规认证并实现快速替代。

从产业格局来看，晶圆代工环节持续占显战略价值。算力芯片领域，逻辑运算类芯片需求爆发式增长，推动设计工具、工艺制程与异构封装技术持续迭代，构筑起涵盖IP核、EDA工具链、工艺制程的全方位技术壁垒；消费电子领域，整体市场温和复苏，系统级芯片、传感器、存储芯片等产品持续通过工艺优化与成本管控构建竞争优势；汽车电子与工业工控领域，由于功能安全认证体系与长周期验证要求，形成了高度集中的产业生态格局。

从地域发展情况来看，在中美贸易政策动态调整背景下，跨国企业加速推进供应链区域化重构，全球供应链体系正经历多维度的适应性变革，近岸产业链布局成为主要经济体战略重点。中国大陆集成电路产业在高端设备、关键原材料及零部件、IC设计能力、工艺开发，封装等关键环节仍具备较大成长空间。

晶圆代工行业作为半导体产业链的核心环节，技术壁垒、人才储备、持续资本投入，形成了较高的准入门槛。该领域的竞争焦点集中在纳米尺度工艺精度控制、新型半导体材料开发应用以及超大规模制造系统的协同优化能力。全球领先企业维持较高的研发投入强度，持续巩固技术优势，着力构筑产业壁垒，而本土企业正通过产业链协同突破，快速填补中高端市场空白。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的2025年销售额情况，中芯国际位居全球第二，在中国大陆企业中排名第一。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，晶圆代工企业多以技术领先性、平台多样性、性能差异化作为吸引客户的核心优势。随着市场需求更趋多元化，企业在纵向追求更小的晶体管结构的同时，也更注重利用晶产工艺节点的性能基础开展横向的衍生平台建设，以满足庞大的终端市场的差异化需求。

与此同时，各类新型封装，设计服务以及光掩模等技术持续突破，为晶圆代工技术迭代赋能。在新型封装技术领域，各类形式的系统性解决方案有效地突破了晶体管线宽极限并进一步提高了多芯片集成的融合度；在设计服务领域，DTCO(Design Technology Co-Optimization，设计工艺协同优化)对具体设计和工艺匹配做评估和调整，有效地降低了半导体工艺开发的成本和使用风险；光掩模作为集成电路制造产业链上的核心关键工具，其掩模工艺和介质材料不断进化，进一步提升设计图形光刻的工艺表现。

伴随全球行业格局的变化，晶圆代工企业在专注自身工艺技术与平台建设的同时，也愈加重视产业生态布局，其产能规模效应和在地化的产业链协同能力已成为客户衡量供应链稳定性和完整性的重要因素之一。

从未来发展趋势看，晶圆代工企业通过持续拓展产能规模、新工艺研发，加强产业链协同等方式不断强化资本、技术和行业生态壁垒，少数企业占据市场主导地位的业态将长期存在，行业头部效应将愈加明显。

公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
总资产	367,718,196	353,415,296	4.0	338,463,197
归属于上市公司股东的净资产	150,823,788	148,190,613	1.8	142,475,834
	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	67,323,192	57,795,570	16.5	45,250,425
利润总额	7,785,646	6,292,022	23.7	6,840,418
归属于上市公司股东的净利润	5,040,734	3,698,665	36.3	4,822,814
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,124,287	2,645,419	55.9	3,269,518
经营活动产生的现金流量净额	20,080,979	22,658,629	-11.4	23,047,761
加权平均净资产收益率(%)	3.4	2.5	增加0.9个百分点	3.5
基本每股收益(元／股)	0.63	0.46	37.0	0.61
稀释每股收益(元／股)	0.63	0.46	37.0	0.61
研发投入占营业收入的比例(%)	8.2	9.4	减少1.2个百分点	11.0

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	16,301,085	16,046,964	17,162,367	17,812,776
归属于上市公司股东的净利润	1,356,374	944,492	1,517,205	1,222,663
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,169,998	733,727	1,273,146	947,416
经营活动产生的现金流量净额	-1,171,520	7,069,313	6,389,758	7,793,428

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

股东情况

(一)普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)(1)	322,045
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)(2)	319,066
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

中芯国际集成电路制造有限公司

公司代码：688981 公司简称：中芯国际

2025年度报告摘要

附注：

(1)截至本报告期末，注册股东户数322,045户中：A股312,092户，港股9,953户。

(2)截至2026年2月28日，注册股东户数319,066户中：A股309,227户，港股9,839户。

(二)截至报告期末前十名股东持股情况表

1.截至本报告期末，本公司于香港已发行6,000,845,486股，约占本公司总股本75.01%，于上交所科创板已发行1,999,562,549股，约占本公司总股本24.99%。

2.本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)及其他登记股东组成，其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。

3.根据香港证券及期货条例，持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需自行进行权益申报。根据股东权益申报情况，大唐香港持有港股1,125,042,595股及鑫芯香港持有港股382,902,023股。公司已将前述股东所持股份数目从HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份数目中剔除。

4.A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	237,375,542	4,479,200,864	55.99		未知		未知
大唐控股(香港)投资有限公司	8,190,000	1,125,042,595	14.06		无		境外法人
鑫芯(香港)投资有限公司	-234,312,781	382,902,023	4.79		无		境外法人
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司		127,458,120	1.59		无		其他
中国信息通信科技集团有限公司		72,470,855	0.91		无		国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-50,080,245	64,509,310	0.81		质押	1,625,000	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-8,575,987	60,320,949	0.75		无		其他
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,679,327	33,463,630	0.42		无		其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-1,408,559	32,990,677	0.41		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.大唐香港为中国信科的全资子公司。 2.鑫芯香港为国家集成电路基金的全资子公司。 3.国家集成电路基金的董事张新、徐文立、李国华、唐雪峰、杨高峰同时担任国家集成电路基金二期的董事；监事秦斌、卢伟同时担任国家集成电路基金二期的监事。 4.华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。 5.国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。 除此之外，公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

(三)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

(四)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

(五)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本集团实现营业收入人民币67,323.2百万元，比上年同期增加16.5%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,040.7百万元，比上年同期增加36.3%。报告期内，本集团的经营活动所得现金净额为人民币20,081.0百万元，较上年同期减少11.4%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币59,950.6百万元，较上年同期增加9.9%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-008

港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中芯国际控股有限公司	6,000,000万元	4,745,350万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
中芯集电投资(上海)有限公司	500,000万元	-		
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	300,000万元	155,000万元		
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	50,000万元	63,500万元		
中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	50,000万元	-		
中芯西青集成电路制造有限公司	50,000万元	-		
芯电半导体(上海)有限公司	50,000万元	-		
合计	7,000,000万元	4,963,850万元	-	-

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至2026年2月28日公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	4,968,430
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	32.94
特别风险提示(如有请勾选)	□本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注：上述担保总额不含本次新增担保金额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)根据其业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计2026年度为子公司以及子公司之间互相提供担保新增额度合计不超过人民币(或等值外币)7,000,000万元。除上述新增担保额度外，截至2026年2月28日，公司及其控股子公司对外担保余额为4,968,430.25万元(已经汇率折算)，相关担保合同期限均超过12个月。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月26日董事会书面决议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》及《对外担保管理制度》的相关要求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。上述担保预计额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年2月28日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
中芯国际集成电路制造有限公司	中芯西青集成电路制造有限公司	100%	75.30%	-	50,000	0.33%	董事会审议通过之日起12个月内	否	否
中芯国际集成电路制造有限公司	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	100%	85.20%	63,500	50,000	0.33%	董事会审议通过之日起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
中芯国际集成电路制造有限公司	中芯国际控股有限公司	100%	23.60%	-	500,000	3.32%	董事会审议通过之日起12个月内	否	否
中芯国际集成电路制造有限公司	中芯集电投资(上海)有限公司	100%	41.50%	155,000	300,000	1.99%	董事会审议通过之日起12个月内	否	否
中芯国际集成电路制造有限公司	中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	100%	28.40%	-	50,000	0.33%	董事会审议通过之日起12个月内	否	否
中芯国际集成电路制造有限公司	芯电半导体(上海)有限公司	100%	4.60%	-	50,000	0.33%	董事会审议通过之日起12个月内	否	否
中芯国际集成电路制造有限公司	中芯国际控股有限公司	100%	64.50%	4,745,350	6,000,000	39.78%	董事会审议通过之日起12个月内	否	否

(四)担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求，在新增担保额度内调剂使用，但资产负债率为70%以上的并表子公司仅能与其他资产负债率为70%以上的并表子公司之间调剂使用本次预计的担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	中芯国际控股有限公司	全资子公司	中芯国际集成电路制造有限公司,100%	91310000322177469
法人	中芯集电投资(上海)有限公司	全资子公司	中芯国际集成电路制造有限公司,100%	91310115754792112E
法人	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	全资子公司	中芯国际集成电路制造有限公司,100%	91310115710939629R
法人	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	全资子公司	中芯国际集成电路制造有限公司,100%	911103027404017237
法人	中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	全资子公司	中芯国际集成电路制造有限公司,100%	91120111717869977N
法人	中芯西青集成电路制造有限公司	全资子公司	中芯国际集成电路制造有限公司,100%	91120111MA820TK93R
法人	芯电半导体(上海)有限公司	全资子公司	中芯国际集成电路制造有限公司,100%	91310115684068232 3

(二)被担保人失信情况

经查询，以上被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年2月28日，公司及其子公司为全资及控股子公司提供的担保余额为4,968,430.25万元(已经汇率折算)，其中为控股子公司提供的担保余额为4,580.25万元(已经汇率折算)。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为32.94%、0.03%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，无逾期担保的情况。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年3月27日

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-007

港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司2026年仍将维持较大规模的资本支出，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2025年度不进行利润分配(包括不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配)。

● 本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)和中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)现行《经修订及重述组织章程大纲及细则》《利润分配政策》等规定，经董事会决议，公司2025年度不进行利润分配(包括不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配)。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及A股其他风险警示情形

公司不触及A股其他风险警示情形，具体说明如下：

单位：人民币千元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	-	-	-
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	5,040,734	3,698,665	4,822,814
母公司报表本年度末累计未分配利润	48,246,108		
最近三个会计年度累计现金分红总额	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	4,520,738		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	是		
现金分红比例(%)	-		
现金分红比例是否低于30%	是		
最近三个会计年度累计研发投入金额	15,957,269		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度营业收入	170,369,187		
最近三个会计年度累计研发投入占营业收入比例(%)	9.4		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年度拟不进行现金分红的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润504,073.4万元，拟不进行利润分配，具体原因说明如下。

(一)公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

1、所处行业及其特点

公司所属晶圆代工行业为半导体产业链的核心环节，技术壁垒、人才储备、持续资本投入，形成了较高的准入门槛。该领域的竞争焦点集中在纳米尺度工艺精度控制、新型半导体材料开发应用以及超大规模制造系统的协同优化能力。全球领先企业维持较高的研发投入强度，持续巩固技术优势，着力构筑产业壁垒，而本土企业正通过产业链协同突破，快速填补中高端市场空白。

2、公司发展阶段及经营模式

当前，公司正处于推进产能建设、不断提升市场占有率的重要发展阶段，公司通过专注本业增强公司自身的核心竞争力和长期价值，确保公司在激烈的市场竞争、不断变化的外部环境下，保持领先地位，为客户及股东创造价值。

3、资金需求

公司预计2026年度仍将维持较大规模的资本支出，预计超过公司最近一期经审计净资产的20%，资金需求较高，公司需预留足够资金来满足产能扩充、发展公司核心业务，充分保障公司平稳运营、健康发展。

(二)公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司2025年度未分配利润将累计滚存至下一年度，主要用于产能扩充以及发展公司核心业务，通过进一步提升产能规模和技术水平，增强行业竞争力，从而实现净资产的稳步增厚和公司价值的不断增长，最大限度维护股东利益。

(三)中小股东参与利润分配决策的便利条件

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线及邮箱等多种方式来表达对利润分配的意见和诉求。

同时，公司将于2026年年度股东大会提交审议《2025年度利润分配方案》，并将采用现场与网络投票相结合的表决方式，为中小股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小股东享有平等权益。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为进一步增强投资者回报水平，公司自2024年起已连续三年制定并披露了“提质增效重回报”行动方案。2026年公司将持续做优存量、挖掘增量，巩固稳健向好的增长态势，在经营管理、研发创新、公司治理、投资者关系及践行ESG理念等方面采取积极措施，推动公司高质量发展，保障投资者权益，进一步增强公司可持续发展韧性。

三、公司履行的决策程序

公司2026年3月26日董事会书面决议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意提交至公司2026年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2026年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：688981 证券简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司2025年度环境、社会及管治(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中芯国际集成电路制造有限公司(简称“公司”或“本公司”)2025年环境、社会及管治(ESG)报告(简称“报告”或“本报告”)全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688981
公司简称	中芯国际
公司名称	中芯国际集成电路制造有限公司
报告范围	中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告编制遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《香港联合交易所证券上市规则》附录C2所载的《环境、社会及管治报告守则》及相关上市规则条文，根据重要性、量化、平衡及一致性的原则要求编写，并适当参考全球报告倡议组织(GRI可持续发展报告标准)(GRI 标准)、中国社会科学院经济学部《中国企业社会责任报 告指南(CASS ESG 5.0)》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国电子工业标准化技术协会《T/CIE 16000-2016《电子信息行业社会责任指南》，以及国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》的主要原则。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG指导委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG指导委员会每年向董事会报告ESG执行情况和未来工作计划 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司建立了明的四级可持续发展治理体系，明确各层级在可持续发展管理方面的监督职责和汇报机制 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	员工福利及待遇 员工个人职业发展 员工培训与教育 员工身心健康 未来成长潜力 公司在产业中竞争优势 人才留任 公司治理	员工沟通大会 全体邮件公告 员工敬业度调查 企业微信公众号 内部网站 道德规范举报热线 其他各类员工活动
股东/投资人	行业景气度 产业政策变化及影响 经营战略 核心竞争优势 经营业绩 市值管理 资本开支及产能建设 同业竞争	公司官网和企业微信公众号 投资者联系电话和电子邮箱 证券交易所投资者关系互动平台 公告 股东大会 投资者说明会 路演和反路演 投资者和券商调研 券商大会 宣传资料 媒体采访 其他合法有效的渠道、平台和方式
客户	客户服务与满意度 创新管理 公司在产业中竞争优势 产品质量管控 机密信息保护 商业道德规范	客户满意度调查 客户业务/质量/技术评核会议 技术研讨会 其他日常客户沟通
供应商	质量、价格、交货、服务 法规遵循 商业道德规范 供应商可持续性管理 反贪腐	考核与评分 现场稽核 质量问卷调查
政府	未来成长潜力 半导体行业展望 公司在产业中竞争优势 污染防控 创新管理	政策宣讲会 座谈会 市场推广会 其他各类会议
社会	公司治理 经济效益 创新管理 反贪腐 社会参与 外部合作 生物多样性保护	新闻稿 采访及专题报道 新闻发布会 白媒体 公益活动 环境保护宣导

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司竞争优势与成长	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	经济效益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
3	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	法律遵循	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
5	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
7	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
8	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
9	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
10	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
11	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
12	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
13	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
14	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
15	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
16	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
17	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
18	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
20	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
21	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
22	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
23	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
24	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
25	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
26	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

注：“科技伦理”议题与公司主营业务关联度较低，未被识别为具有财务重要性或影 响重要性的议题。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—— 可持续发展报告(试行)》第七条要求，在报告中对该议题不具有重要性的原因进行 了说明。

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-008

江苏